

有研半导体硅材料股份公司 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利人民币0.1元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●实施权益分派的股权登记日前有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

●公司2023年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

公司于2023年8月8日召开的第一届董事会第十五次会议及2023年8月29日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》,并实施完成2023年半年度权益分派。此次利润分配以实施权益分派的股权登记日(2023年9月25日)登记的总股本1,247,621,058为

基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 74,857,263.48 元。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 152,396,023.99 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,247,621,058 股，以此计算本次拟派发现金红利 12,476,210.58 元（含税），加上 2023 年半年度已分配的现金红利，全年累计派发现金红利 87,333,474.06 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 34.36%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本次分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发

展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024年3月29日